

強強聯手！臻鼎科技與尖點科技簽署戰略合作協議 共創高階 PCB鑽孔技術新格局

2025年12月1日，全球PCB領導大廠臻鼎科技集團（股票代號：4958）與精密鑽針及鑽孔解決方案領導廠商尖點科技（股票代號：8021）於深圳鵬鼎時代大廈正式簽署戰略合作協議。臻鼎科技集團董事長沈慶芳與尖點科技董事長林序庭共同出席簽約儀式，雙方高階主管亦到場見證此重要里程碑。



▲臻鼎科技集團董事長沈慶芳(右)與尖點科技董事長林序庭(左)合影。

雙方此次簽署戰略合作協議，正式建立全面的策略夥伴關係，聚焦於高階電路板精密鑽孔技術、微型鑽針研發、AI伺服器與先進載板應用等領域的技術創新與市場拓展。

尖點科技長期深耕印刷電路板（PCB）精密鑽針及鑽孔加工解決方案，具備卓越的研發與量產能力，並在AI伺服器、ABF載板、高速網通、HDI等高階應用領域擁有深厚技術實力。透過本次合作，尖點將與臻鼎科技攜手開發高效率、高可靠度的先進鑽孔製程技術，推動兩家公司於高端電子產業的深度合作。

臻鼎科技集團作為全球PCB產業領導者，持續投入高階載板與AI伺服器相關領域。此次與尖點的合作，將充分結合雙方在精密鑽孔製程與高端材料應用上的技術優勢，進一步完善產業鏈協作體系，加速智慧製造與永續發展布局。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳表示：「尖點科技在精密鑽孔與高性能鑽針研發領域具備世界級的技術實力與創新能量。臻鼎非常重視此次合作，期望雙方能在AI伺服器、先進載板與高速通訊應用上展開深度共創，共同推動產業升級與技術突破。」



尖點科技董事長林序庭表示：「臻鼎科技集團作為全球 PCB 產業的領航者，長期引領產業技術與製造革新。尖點非常榮幸能成為臻鼎的重要策略夥伴，未來將結合雙方在產品、製程與設備領域的核心優勢，共同打造高效率、高品質的鑽孔精密加工解決方案，為電子產業的永續發展注入新動能。」

未來，臻鼎科技集團與尖點科技將持續深化在新產品開發升級、供應鏈戰略整合、AI 智慧製造與綠色永續等多面向合作，共同推動 PCB 產業邁向高精度、高效率與高附加價值的嶄新階段。

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2024 年連續八年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站：www.zdtco.com。

關於尖點科技

尖點科技股份有限公司(台灣證券交易所股票代號：8021)成立於 1996 年，為全球精密鑽針研發、生產與銷售領先廠商，同時提供印刷電路板 (PCB) 產業先進的鑽孔加工整合方案。尖點以材料科學、精密製造與表面鍍膜技術為核心，具備覆蓋鑽針、銑刀、機械鑽孔及雷射鑽孔的完整產品與服務組合，廣泛應用於 IC 載板、HDI、RPCB、FPC、ABF、HLC 等各類高階電路板製程領域。尖點致力以高品質、高效率與高可靠度的產品與服務，協助客戶提升產能與製程良率，並以永續發展與創新驅動為目標，成為 PCB 精密加工領域值得信賴的世界級專業服務公司。更多詳細資訊請至公司網站：www.topoint.tw。



臻鼎公司發言人:

凌 悳

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com

尖點公司發言人:

張家齊

管理中心

電話: 886 2 26805868

Email: allen_chang@topoint.tw